

國立政治大學 函

機關地址：臺北市文山區指南路二段64號
聯絡人：張弘諺
聯絡電話：02-29393091#66899

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國110年1月13日

發文字號：政研發字第1100000995號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件一科技部函、附件二徵求說明書、附件三科技部補助產學合作研究計畫作業要點

主旨：科技部公開徵求「半導體產學研發聯盟計畫」（原產學研發聯盟REsearch ALLiance, REAL計畫），校內截止收件時間為110年2月4日（四）下午5時止，逾期不予受理，請查照轉知

說明：

- 一、依科技部110年1月8日科部產字第1100002345號函（如附件一）辦理。
- 二、旨揭計畫乃著眼於國家科技、經濟與產業發展的迫切需求，科技部鼓勵國內產業界與學術界組成半導體產學研發聯盟，透過創新的產學合作模式，引導產業界、學術界結合研發能量，共同規劃未來關鍵研究主題，促進產學共同投入產業前瞻技術研究，以強化產業發展的關鍵技術研發及智財布局，更協助產業界、學術界共同培育高階研發領導人才。
- 三、申請注意事項：
 - （一）合作企業：現金出資不得少於新臺幣200萬元，須於計畫執行期間內撥付，且應高於向科技部申請補助經費，並符合科技部「補助產學合作研究計畫作業要點」（如附件三）第二點規定者。

- (二) 分為 IC 設計、製造及封測三組，請於申請書之計畫名稱註明申請組別。
- (三) 計畫申請書應檢附：「計畫推薦機構審核資料」、「申請人與企業之合作約定書」函送科技部，其中「計畫推薦機構審核資料」須以密封形式函送科技部，科技部將依申請人建議之推薦機構，將「計畫推薦機構審核資料」送推薦機構進行審核；另科技部辦理計畫審查時，得通知申請人到科技部報告。
- (四) 申請書下載路徑：<https://www.most.gov.tw/?l=ch/學術研發服務網登入/學術獎補助申辦及查詢/專題研究計畫>，計畫類別為「半導體產學研發聯盟計畫」。
- 四、有意申請者請於旨揭截止日期前完成線上申請作業，並請所屬單位於次日中午前將申請名冊（經單位主管核章）送達研發處，俾利備函彙送科技部提出申請。
- 五、本計畫未獲通過補助者，將不受理申覆。
- 六、本計畫相關申請疑義，請洽科技部半導體產學研發聯盟計畫辦公室陳于純小姐；電話：02-2737-7288。有關系統操作問題，請洽科技部資訊處，電話：0800-212-058、02-2737-7590~2737-7592。

正本：本校各院、系、所、研究中心(電子布告欄)

副本：研究發展處

校長 郭明政